



# 包装封口量测分析与应用

如果一个制造公司，它的封装仪器，表现出不良的封装质量，那么对于这个公司而言，有可能会造成产品大量的损坏。这有可能是因为一些不平整的压杆、低压应力或封装配件磨耗的影响，所造成的结果。**I-Scan**® 系统目前已经服务于多项封装应用，能够为您检测出这些仪器的问题所在。

在下面的应用，Tekscan 5570 感测片正服务于此。内含 44 个感测点，并完全包覆着封压杆件的内侧(图 1)。将传感器置于 2 片封压杆件之间，并且关闭封口，则 **I-Scan** 操作软件便显示其封口的 3-D 压力分布图形并且纪录。从图 2 的量测结果可以看出，2 端的高度位置略微偏低，这便是代表封口压力较低、密封力量较为脆弱的地方。发现这种问题，便需进行机器调整，并同时不断地观看量测结果。等到量测的压力图形较为平均时(图 3)，则表示此时的压杆能够提供较均匀的封压应力，如此才能产生较好的封口质量。



图1. 将 I-Scan 传感器片于封压杆之间

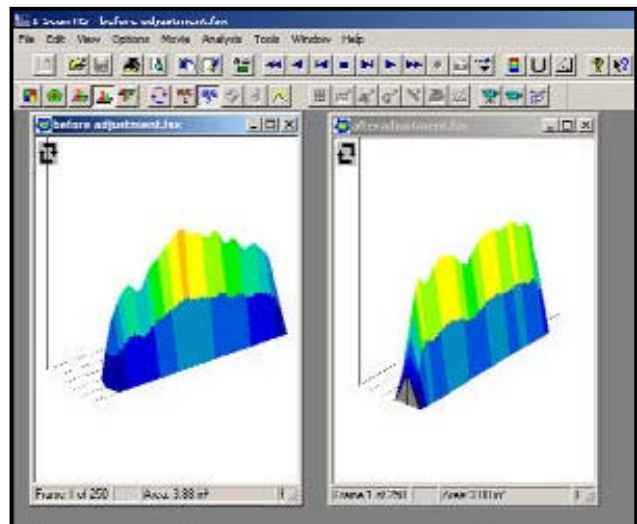


图2. 仪器调整前

图3. 仪器调整后

**I-Scan** 系统在这个应用领域里，已经成为了一个很有实用的装配工具。在仪器正式进入产品生产作业前，藉由封口压力的调整，便能够避免产品大量的损坏。除此之外，**I-Scan** 亦可用于检查仪器磨损、架设新的机台，并且在产品生产过程中，改善所有的质量控管。**I-Scan** 传感器不但可制作成各种外型，并且可重复使用，提供您精准和正确的压力数据。藉由 Tekscan 专业的服务人员与工程团队的协助，您将可以利用这套系统，解决在您各种应用上的特殊需求。